

Pressemitteilung

Februar 2006

CADFEM

CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing b. München

Telefon +49 (0)8092-7005-0
Telefax +49 (0)8092-7005-77
E-Mail marketing@cadfem.de
Internet <http://www.cadfem.de>

Wenn Sie Rückfragen zu nachstehender Meldung haben, weitergehende Informationen, eine elektronische Version oder Bildmaterial dazu benötigen, wenden Sie sich bitte an Alexander Kunz, Telefon 0711-990 74 5-20, E-Mail akunz@cadfem.de

HANNOVERMESSE - DIGITAL FACTORY - Halle 15 Stand C04

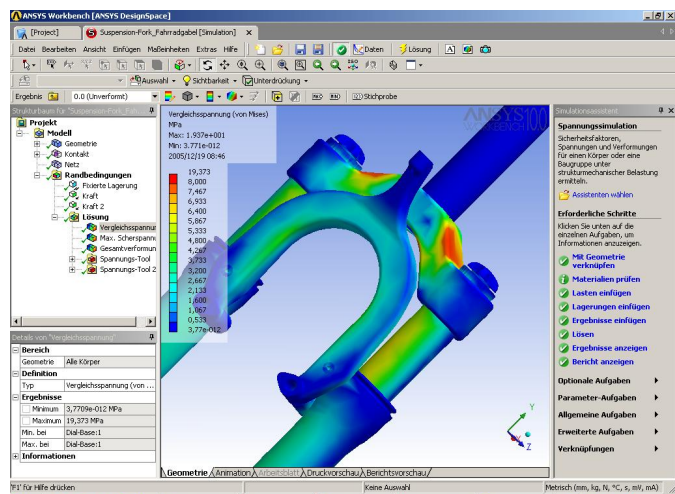
ANSYS, DesignSpace & (viel) mehr: CADFEM auf der HMI 2006



Simulationstechnologien für Entwickler und Konstrukteure am Stand der CADFEM GmbH in der „Digital Factory“ vom 24. – 28. April 2006 in Hannover.

Als Spezialist für Berechnung und Simulation in der Produktentwicklung präsentiert die CADFEM GmbH auf der Hannovermesse 2006 im Bereich „Digital Factory“ ihr umfangreiches Spektrum an Software und Dienstleistungen. Die Hauptprodukte ANSYS Workbench 10.0 für komplexe strukturmechanische, strömungsmechanische und gekoppelte Simulationen („Multiphysik“) sowie DesignSpace für konstruktionsnahe Berechnungen werden ergänzt durch spezifische Branchenlösungen. Mit dem Programm Harvard Thermal präsentiert CADFEM erstmals eine hocheffiziente Lösung für thermische Berechnungen in der Mikroelektronik.

Nachdem CADFEM in den vergangenen Jahren auf der Hannovermesse an verschiedenen Gemeinschaftsständen ausstellte, hat sich der Spezialist für die rechnerische Simulation 2006 zu einem eigenen Stand entschlossen: Der CADFEM Stand mit seinem umfassenden Spektrum an Simulationslösungen für die Produktentwicklung befindet sich im Bereich der Leitmesse „Digital Factory“ in Halle 15, Standnummer C04.



Konstruktionsbegleitende Berechnung einer Fahrradgabel mit dem Programm ANSYS DesignSpace

Das CADFEM Programm in Hannover im Überblick:

ANSYS Workbench: Struktur, Strömung, Emag, Multiphysik



Der Name ANSYS steht für ein komplettes Angebot an High-End FEM-Simulationstechnologie, genutzt von der größten Anwender-Community weltweit. Branchenübergreifend decken ANSYS Softwarepakete einen Großteil der heute möglichen FEM-basierten Simulationsanwendungen in der Produktentwicklung ab: In den Bereichen Strukturmechanik, Strömungsmechanik (ANSYS CFX) und Elektromagnetik bietet ANSYS ein breites Spektrum an Berechnungsmöglichkeiten – einzeln oder als gekoppelte Anwendung verschiedener physikalischer Effekte („Multiphysik“), z.B. für Fluid-Struktur-Interaktion. Mit der Benutzerumgebung Workbench hat ANSYS die Voraussetzung für den durchgehenden und integrierten entwicklungsbegleitenden Einsatz der Simulation geschaffen.

DesignSpace: Konstruktionsbegleitende Berechnung



ANSYS DesignSpace ist die speziell für Anwendungen in der 3D-CAD Konstruktionsumgebung entwickelte Berechnungslösung. Nahtlos integriert in führende CAD-Systeme liefert DesignSpace dem Konstrukteur schnell wichtige Erkenntnisse zur Machbarkeit seiner Bauteile und Baugruppen.

LS-DYNA: Crash, Aufprall, Umformung



Das Programm LS-DYNA ist weltweit führend auf dem Gebiet der expliziten Berechnung, d.h. der Simulation hochgradig nichtlinearer, dynamischer Vorgänge. Zum Einsatz kommt LS-DYNA vor allem bei Herstellern, Zulieferern und Engineering-Dienstleistern der Automobilindustrie, im Schiff- und Schienenfahrzeugbau sowie im Bereich Luft- und Raumfahrt. Verstärkt wird LS-DYNA aber auch in anderen Branchen eingesetzt, etwa für Falltests im Konsumgüterbereich.

FTI-Lösungen für die Blechbauteilentwicklung



Mit ihren Simulationstechnologien für verschiedene Anwendungen der blechverarbeitenden Industrie bieten die FTI-Programmpakete hocheffiziente Werkzeuge für diese Branche. Zu den Lösungen von FTI gehören Programme zur Herstellbarkeitsbewertung, Werkzeugentwicklung, Prozess- und Produktkostenanalyse.

Moldflow: Spritzgießsimulation



Moldflow ist das weltweit führende Softwareprogramm zur Simulation und Auslegung von Spritzgießprozessen. Die Schnittstelle von Moldflow zu ANSYS ermöglicht eine äußerst effiziente Kopplung von Füll- und Festigkeitsberechnung.

Neu: Harvard Thermal



Harvard Thermal bietet herausragende Simulationswerkzeuge zur 3D-Analyse thermischer Vorgänge in der Mikroelektronik, z.B. Temperaturentwicklung von Elektronikkomponenten oder Kühlvorgänge von PCB's. Schnittstellen zu allen gängigen ECAD-Systemen unterstützen die effiziente Integration des Programms in den Entwicklungsprozess. Im Oktober 2005 wurde Harvard Thermal von ANSYS, Inc. akquiriert.

Über die CADFEM GmbH

Als Distributor von FTI, ANSYS und LSTC (LS-DYNA) in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist CADFEM eine der ersten Adressen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Produkte und Dienstleistungen rund um die rechnerische Simulation mit FEM geht. Sitz des Unternehmens, das sich als Ingenieurbüro und Systemhaus versteht, ist Grafing bei München. Darüber hinaus gibt es weitere Geschäftsstellen in Deutschland sowie Partner im deutschsprachigen Ausland und in Osteuropa. Außer den meisten deutschen Großkonzernen gehören viele mittelständische und kleine Unternehmen sowie Ingenieurbüros zu den von CADFEM betreuten Kunden. Darüber hinaus besteht ein enger Kontakt mit technisch ausgerichteten Hochschulen. Zu den Tätigkeitsfeldern der CADFEM gehören Projektbearbeitung, Seminare, Beratung, Vertrieb von weltweit führenden FE-Programmen und der erforderlichen IT-Infrastruktur, Anwendersupport und Entwicklung kundenspezifischer Programm-Routinen.

Kontakt:

CADFEM GmbH, Marktplatz 2, 85567 Grafing bei München, Telefon +49 (0)8092-7005-0, Telefax +49 (0)8092-7005-77, E-Mail info@cadfem.de, Internet www.cadfem.de

Auf der Hannovermesse 2006 / „Digital Factory“ in Halle 15, Stand C04